

深圳市龙图光罩股份有限公司

关于先进封装客户合作事项的风险提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、传闻简述

近期，公司因在投资者调研活动中提及“与华天科技、通富微电、日月光等先进封装厂商的合作情况”，引发部分媒体及投资者解读，并在二级市场产生一定传播。为避免对市场造成误导，公司现就相关事项予以说明。

二、核实情况说明

（一）关于先进封装用掩模版的业务定位

公司在2026年6月30日披露的投资者调研纪要中已说明：先进封装目前对图形密度、堆叠结构及界面精度要求提升，RDL层数变多、线宽更细、TSV/Hybrid Bonding引入更多对准与图形化步骤，过程中均需掩模参与，对公司而言是重要的中长期增量方向。

但需要向投资者特别说明的是：先进封装用掩模相比半导体IC用掩模，线宽要求一般为微米或亚微米级，层数一般没有半导体IC复杂。先进封装掩模版的技术节点与单价水平，整体低于公司半导体IC掩模版产品线，对公司业绩贡献相对有限。

（二）关于与日月光、通富微电、华天科技的合作进展

截至目前，前述日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段，华天科技销售金额占公司营业收入比例较低。公司营业收入构成中，封装产品整体收入占比也较低，对公司业绩影响有限。

三、重要提示

1、股价波动受多种因素影响，提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，避免基于传闻进行投资操作，切实维护自身合法权益。

2、公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2026年7月2日